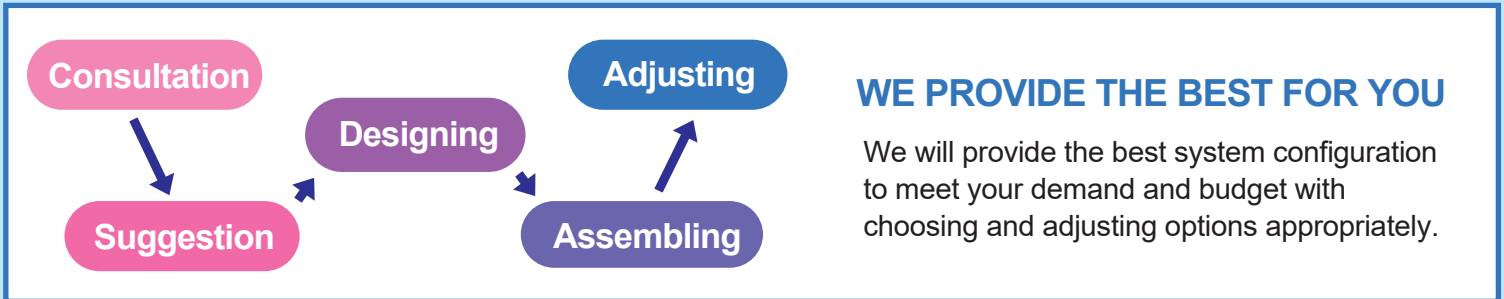
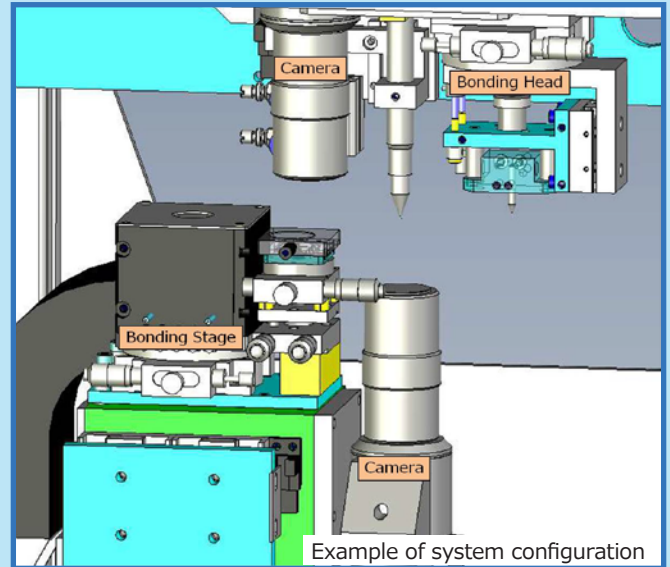
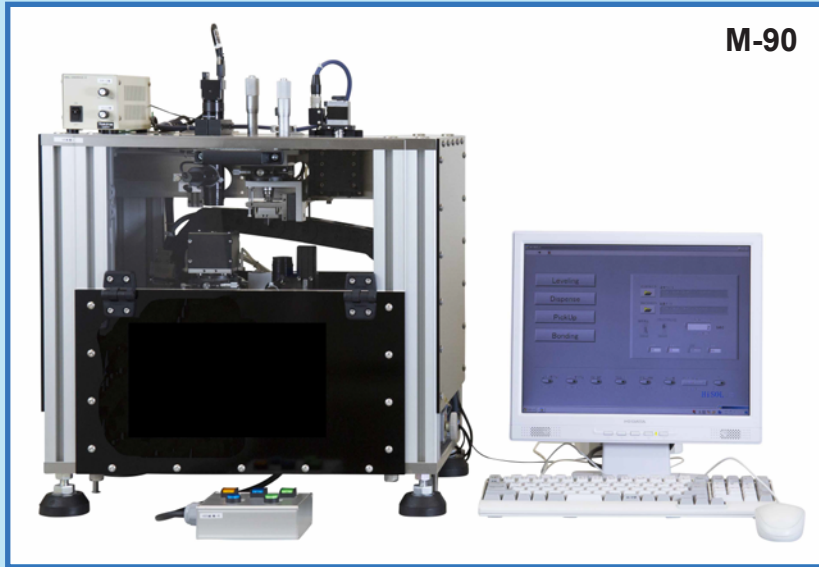


Ideal for R & D, Prototype production!

Achieves High-Precision Bonding!

# Desktop Flip Chip Bonder M90



**HiSOL, INC.**

<https://www.hisol.jp/en/>



## 1. Products

Flip chip bonder M90 is a small bonding machine that can be installed on the desktop. With a low-cost investment, customer will be able to achieve high-accuracy bonding in the order of microns. The wiring length can be shortened so that electrical loss can be lowered. Compatible with various devices by changing the stage and collet parts. Most suitable for fabricating and developing prototypes, and collecting setting data of mass-production equipment.

## 2. Advantages

- Serving both die bonding and flip chip bonding
- Supporting thermo-compression/adhesive/metal eutectic/ultrasonic bonding and various other methods
- Highly repeatable packaging can be achieved easily by the PC software operation system
- Available to design the system configuration with optional items to meet customers' purposes and budgets
- Covering a wide range of load variation up to 400 N

## 3. Performance

Domestic sales: about 50 systems

Some of them have been delivered to overseas factories of Japanese capital companies

## 4. Expected partners and customers

Local agents and trading companies dealing with universities and public/corporates research institutes.

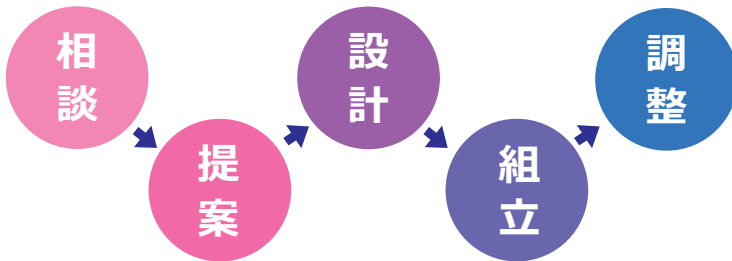
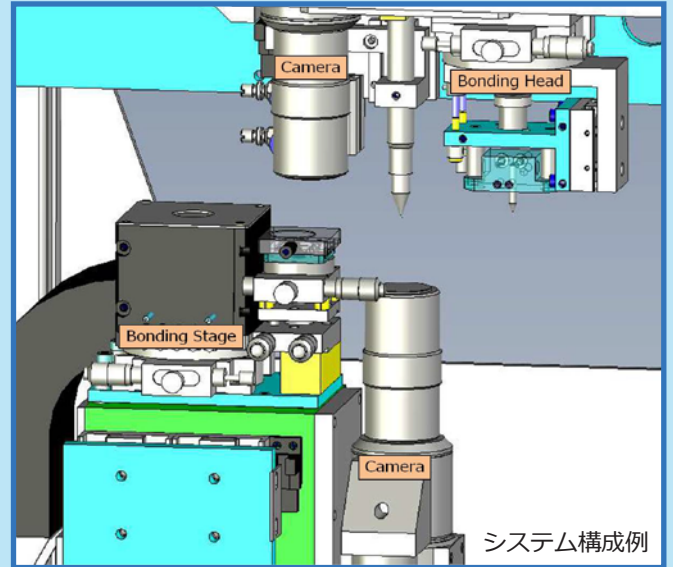
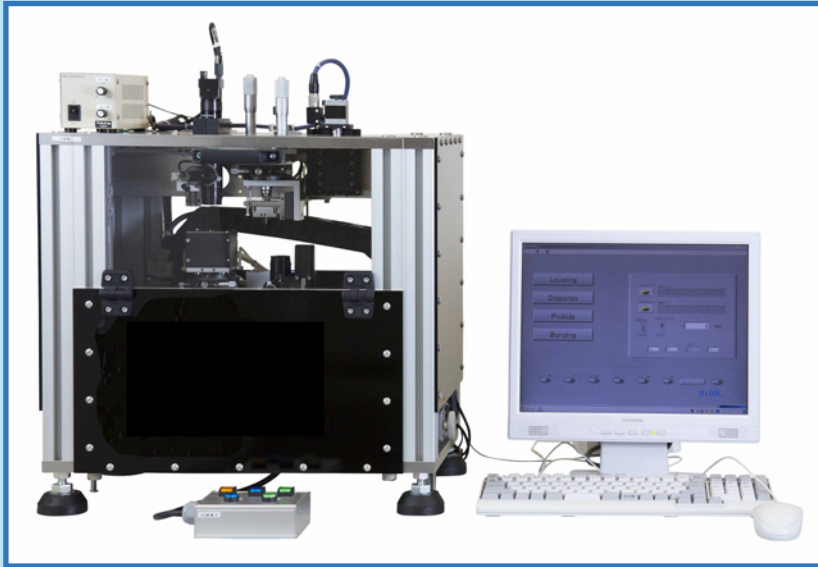


Please send your inquiry to: Tokyo SME Support Center  
TEL +81-3-5822-7241 FAX +81-3-5822-7240 E-mail [ttc@tokyo-kosha.or.jp](mailto:ttc@tokyo-kosha.or.jp)  
URL <https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/en/>

Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

試作・実験に最適！ 小型で高い実装精度を実現！

## 研究開発用 卓上型フリップチップボンダー M90



### 最適なシステムをご提案

要望・予算にそったシステムをご提案。お客様のデバイスに最適な装置設計を行い、組立後も話し合いを持ちながら調整を加え、ベストなソリューションをご提供いたします。

## ハイソル株式会社

<https://www.hisol.jp/>



### 1. 製品について

フリップチップボンダー M90 は、卓上に設置できる小型のボンディング装置です。お客様は低コストの投資で、ミクロンオーダーの高精度なボンディングを実現することができます。省スペースで、配線長が短くなり電氣的に低損失なボンディングが可能です。ステージ/コレットのパーツ交換により、多様なデバイスに対応します。試作品製作、開発、量産装置の条件設定に最適です。

### 2. 製品の特長

- ・フリップチップボンディング / ダイボンディングの両方が可能
- ・熱圧着、接着剤塗布、金属共晶、超音波接合等、各種実装工法に対応
- ・PCによるシステム制御で、簡便で再現性の高い実装精度を実現 - 微細な稼働軸の調整も可能
- ・用途・目的によりオプション構成が組換えられる高い汎用性
- ・400 ニュートンまでカバーする広範囲荷重モデル

### 3. 販売実績

国内納入実績：約 50 台 海外の日系企業工場への納入実績あり

### 4. 希望取引先

東南アジアで公的研究機関・企業研究所、大学と取引のある代理店・商社  
半導体実装分野に精通しているとベター